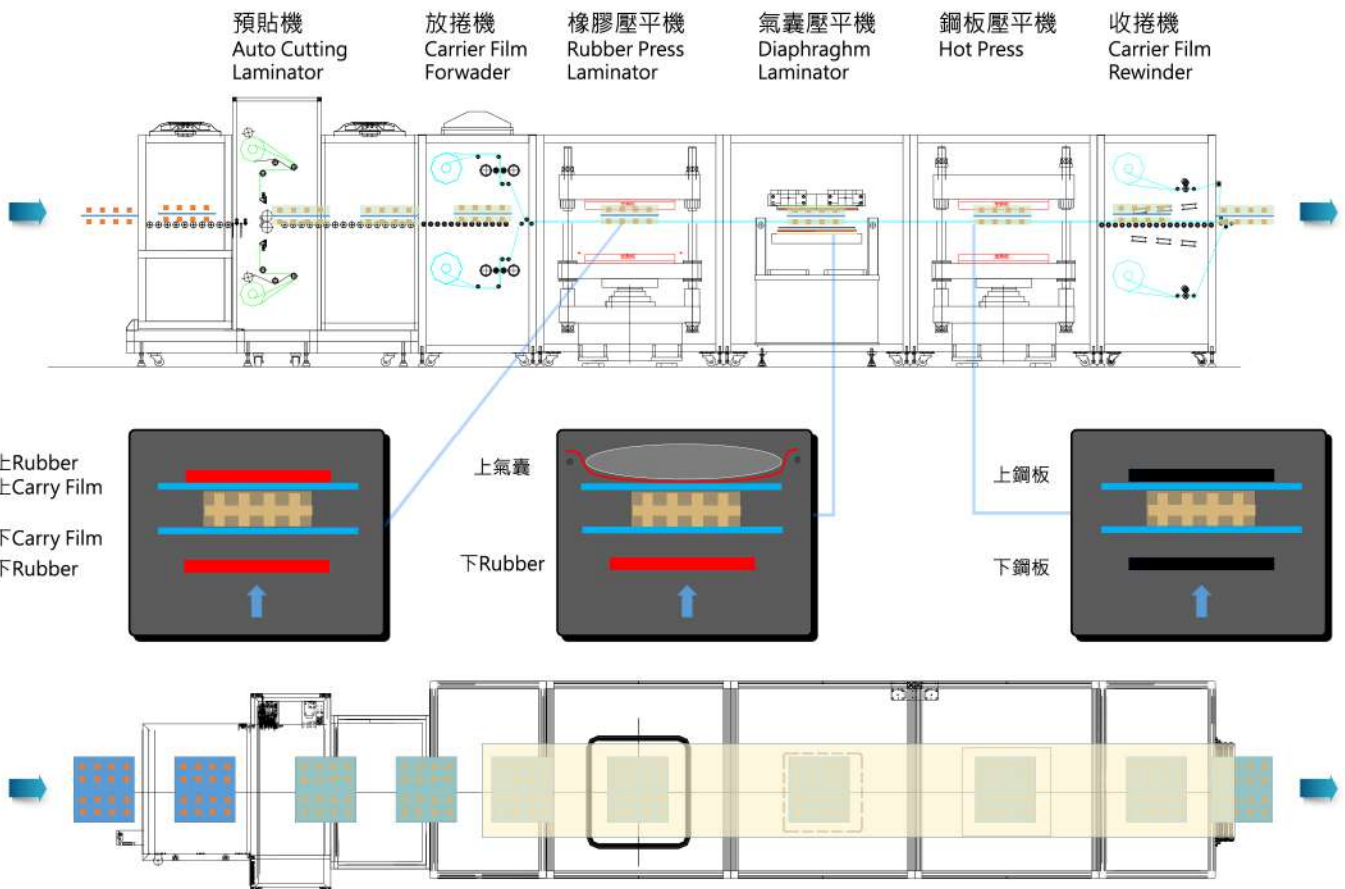


真空壓平貼膜機

VACUUM PRESS LEVELLING LAMINATION MACHINE



應用:

FPC多層板線路真空貼膜製程
PCB 鍍化(OSP)乾膜貼膜製程
PCB/BGA 綠漆乾膜(DFSR) 貼膜製程

FPC 感光性PIC材料壓合製程
PCB/BGA 液態綠漆 真空整平製程
BGA 絕緣層ABF真空貼膜製程

MINI LED 貼膜製程

特點:

1. 可以在真空狀態下加壓貼膜
2. 由於是壓縮空氣加壓,因此對於製品可以實現表面和內部都均勻加壓
3. 在真空腔內部可以實現從上下兩面同時進行加熱
4. 使用非常柔軟的橡膠進行加壓
5. 由於是通過傳導膜搬運基板,而並非進入真空腔內後馬上進行貼膜,因此可以實現無間隙貼膜
6. 氣囊壓平段常用操作溫度100°C 精度±5°C以內, 壓合壓力常用操作壓力0.5Mpa
7. 高真空度可以預防壓合時微小氣泡的產生, 能施均勻壓力於基板上並讓壓膜材料有效地嵌入。
8. 設備實際配置,依客戶製程需求選配

